

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-10

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	汇添富基金、富国基金、大成基金
时间	2025 年 10 月 14 日
地点	上虞
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司半导体衬底材料的主要布局？ 答：在半导体衬底材料领域，公司拥有碳化硅衬底材料、蓝宝石衬底材料及培育金刚石的规模化产能，蓝宝石材料实现技术和规模双领先，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，并突破 12 英寸碳化硅晶体生长技术。 2、请问公司 12 寸碳化硅衬底材料的进展？ 答：9 月 26 日，公司首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线在子公司浙江晶瑞 SuperSiC 正式通线，至此，子公司浙江晶瑞 SuperSiC 真正实现了从晶体生长、加工到检测环节的全线设备自主研发，100% 国产化，标志着晶盛在全球 SiC 衬底技术从并跑向领跑迈进，迈入高效智造新阶段。未来，公司将加速推进产线的量产进程，为客户提供高质量、低成本的大尺寸碳化硅衬底，携手产业链伙伴，共同推动我国第三代半导体产业蓬勃发展。 3、可否展开介绍一下这次 12 英寸碳化硅衬底中试线的设备情况？ 答：子公司浙江晶瑞 SuperSiC 此次贯通的中试线，覆盖了晶体

	加工，切割，减薄，倒角，研磨，抛光，清洗，检测的全流程工艺，所有环节均采用国产设备与自主技术，高精密减薄机、倒角机、双面精密研磨机等核心加工设备更是由公司历时多年自研攻关完成，性能指标达到行业领先水平。自此，晶盛机电正式形成了 12 英寸 SiC 衬底从装备到材料的完整闭环，彻底解决了关键装备“卡脖子”风险，为下游产业提供了成本与效率的新基准。 4、请问公司碳化硅衬底材料的产能布局？ 答：公司积极布局碳化硅产能，在上虞布局年产 30 万片碳化硅衬底项目；并基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，进一步强化公司在全球市场的供应能力；同时，在银川投建年产 60 万片 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，不断强化公司在碳化硅衬底材料领域的技术和规模优势。 5、公司在半导体设备板块的布局？ 答：公司主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。在半导体集成电路装备领域，公司实现半导体 8-12 英寸大硅片设备的国产化，并延伸拓展至芯片制造和先进封装领域。在化合物半导体装备领域，公司聚焦第三代半导体碳化硅装备研发，在晶体生长、加工、外延等环节成功突破多项核心技术。在新能源光伏装备领域，公司实现了硅片、电池片及组件环节核心设备的产业链闭环，是技术、规模双领先的光伏设备供应商。 6、请问公司半导体装备订单情况？ 答：受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税）。
--	---